

# DIE 333 WICHTIGSTEN AKRONYME DER ELEKTRONIKPRODUKTION ENTSCHLÜSSELT - DAS ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS -



ANDREAS WALTER



# Die 333 wichtigsten Akronyme der Elektronikproduktion entschlüsselt

Das Abkürzungsverzeichnis

1. Auflage, April 2020

© 2020 Andreas Walter

# Vorwort

Jedes Fachgebiet hat seine eigenen Akronyme und Abkürzungen. Speziell in der Elektronikbranche werden verschiedene gleichlautende Akronyme und Abkürzungen international mit unterschiedlichen Bedeutungen verwendet. Ähnlich klingende Abkürzungen werden deshalb oft auch von Profis durcheinander gebracht.

Dieses eBook ist eine Aufstellung der gebräuchlichsten und am häufigsten verwendeten Akronyme und Abkürzungen in der Elektronikbranche. Es soll Dir dabei helfen, dich im Berufsalltag besser und leichter zurecht zu finden. Nach dem Lesen dieses eBooks wird es dir deutlich leichter fallen, zu verstehen was die vielen Experten, wie ganz selbstverständlich, beschreiben und vollkommen unterbewusst aussprechen.

Du bist sehr gerne eingeladen, uns in den Sozialen Medien zu folgen und dich weiter zu informieren, aber auch gerne mitzudiskutieren und dein Wissen und deine Erfahrungen mit uns zu teilen.



@MyElectronicAcademy



Electronic Academy



Electronic Academy

Interessiert Dich ein spezielles Thema, so würden wir uns über eine Nachricht von dir freuen, um dich dabei zu unterstützen.

[kontakt@electronic-academy.com](mailto:kontakt@electronic-academy.com)



# Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	3
Inhalt.....	5
Fazit.....	17
Über Andres Walter .....	18
Hinweise .....	19

# Inhalt

## Symbole und Ziffern

Symbole	Englisch	Deutsch
$\Delta T$	Temperature Delta	Temperaturdifferenz
$\mu C$	Microcontroller	Ein-Chip-Computersystem
$\mu Via$	Micro Via	Kleinst-Verbindungsloch

Ziffern		
2D	Two Dimensional	Zweidimensional
3D	Three Dimensional	Dreidimensional
5D	Five Dimensional	Fünfdimensional
$6 \sigma$	Six Sigma (Quality tool)	6 Sigma (Qualitätstool)

## Akronyme / Abkürzungen

A		
AABUS	As Agreed Between User and Supplier	Wie zwischen Anwender und Lieferant abgestimmt
AC	Alternating Current	Wechselstrom
ADJ	Adjust	Justieren
AEC	Automotive Electronics Council	Organisation zur Standardisierung der Qualifizierung von Elektronikkomponenten in der Automobilzulieferindustrie
AECQ	Automotive Electronics Council - Qualified (Component)	Nach AEC Richtlinien qualifiziertes Bauteil
Ag	Silver	Silber
Al	Aluminum	Aluminium
AMP	Amperage (Ampere)	Stromstärke (Ampere)
ANSI	American National Standard Institute	Nationales Amerikanisches Normungsinstitut
AOI	Automated Optical Inspection	Automatische Optische Inspektion
AQL	Acceptance Quality Level	Annehmbarer / Zulässiger Grenzwert
AR	Annular Ring	Restring
AR	Aspect Ratio	Seitenverhältnis
ASIC	Application Specific Integrated Circuit	Anwendungsspezifische integrierte Schaltung
ASSY	Assembly	Bestückung
Au	Gold	Gold

AWG	American Wire Gauge	Amerikanisches Drahtmaß
AXI	Automated X-Ray Inspection	Automatische Röntgeninspektion

<b>B</b>		
BGA	Ball Grid Array	Rasteranordnung von Lotkugelanschlüssen
BIST	Built In Self Test	Eingebauter Selbsttest
BOM	Bill of Material	Stückliste
BS	Boundary Scan	Strukturell / Funktionaler Test
BSDL	Boundary Scan Description Language	Sprache zur Beschreibung von Boundary-Scan-Test-Fähigkeit
BTC	Bottom Termination Component	Komponente mit unten liegenden Anschlüssen
BTO	Build To Order	Produktion gemäß Bestellung

<b>C</b>		
C	Capacitor	Kondensator
C	Celsius	Celsius
CAD	Computer Aided Design	Rechnerunterstützte Konstruktion
CAF	Conductive Anodic Filament	Leitfähiges anodisches Filament
CAM	Computer Aided Manufacturing	Rechnergestützte Produktion
CBGA	Ceramic Ball Grid Array	Keramikgehäuse mit Rasteranordnung von Lotkugelanschlüssen
CE	Conformité Européenne (In Accordance with EU Directives)	Kennzeichnung "Produkt genügt den geltenden Anforderungen"
CEM	Composite Epoxy Material	Leiterplatte auf Hartpapierbasis
CFO	Configure to Order	Konfiguration gemäß Bestellabruf
CGA	Column Grid Array	Bauteil mit rasterförmigen Anschlussreihen
CLK	Clock	Takt
CM	Contract Manufacturer	Auftragsfertiger
COB	Chip-on-Board	Montage ungehäuster Bauelemente
CoC	Certificate of Compliance	Zertifikat der Übereinstimmung
COG	Component Obsolescence Group	Industrieverband zum Thema Abgekündigte Bauteile
Cp	Capability Performance Index	Prozessfähigkeitsindex
Cpk	Process Capability Index	Kleinster Prozessfähigkeitsindex
CPLD	Complex Programmable Logic Device	Programmierbare Logische Schaltung
CQFP	Ceramic Quad Flat Pack	Quadratisches Keramik-Flachgehäuse
CRT	Cathode-Ray Tube	Kathodenstrahlröhre
CSA	Canadian Standard Agency	Kanadische Organisation für Standardisierung

CSP	Chip Scale Package	Gehäuse in der Größenordnung des Die
CTE	Coefficient of Thermal Expansion	Thermischer Ausdehnungskoeffizient
CTI	Comparative Tracking Index	Kriechstromfestigkeit
Cu	Copper	Kupfer

D		
D	Diode	Diode
dB	Decibel	Dezibel
DC	Direct Current	Gleichstrom
Df	Dissipation Factor, Loss Tangent	Verlustfaktor
DfA	Design for Assembly	Montagegerechtes Design
DfBA	Design for Board Assembly	Design für Leiterplattenmontage
DfC	Design for Cost	Kostenbewusstes Design
DfDS	Design for Demand / Supply Chain	Design mit Bezug auf Materialverfügbarkeit
DfE	Design for Environment	Umweltgerechtes Design
DfFA	Design for Final Assembly	Endmontagegerechtes Design
DfM	Design for Manufacturing	Fertigungsgerechtes Design
DfP	Design for Packaging	Verpackungsgerechtes Design
DfR	Design for Reliability	Lebensdauergerchtes Design
DfRP	Design for Repair	Reparaturgerechtes Design
DfS	Design for Service	Wartungsgerechtes Design
DfSC	Design for Supply Chain	Design mit Bezug auf Materialfluss
DfSE	Design for Security	Sicherheitsgerechtes Design
DfSM	Design for Supply Management	Design mit Bezug auf Materialmanagement
DfT	Design for Testing	Testgerechtes Design
DfX	Design for Excellence	Überbegriff - Exzellentes Design
DIL	Dual-In-Line Package	Doppelreihenanschluss-Gehäuse
DIN	-	Deutsches Institut für Normung
Dr	Dielectric Constant	Dielektrizitätszahl
DMA	Dynamic Mechanical Analyze	Dynamisch-Mechanische Analyse
DMM	Digital Multimeter	Digitales Multimeter
DMS	Strain gauge	Dehnungsmessstreifen
DNP	Do Not Populate / Place	Nicht zu bestückendes Bauteil
DNP	Distance to Neutral Point	Abstand zum Nullpunkt
DOE	Design of Experiments	Statistische Versuchsplanung
DP	Drill Program	Bohrprogramm
DPA	Destructive Physical Analysis	Zerstörende physikalische Analyse
DPMO	Defect part per Million Opportunities	Fehler pro Million Möglichkeiten
DRC	Design Rule Check	Prüfung auf Einhaltung von Designregeln

DSC	Differential Scanning Calorimetry	Charakterisierung von Polymeren mittels Differential Scanning Kalorimetrie
DSP	Digital Signal Processor	Digitaler Signalprozessor
DUT	Device Under Test	Prüfling im Test
DVM	Digital Voltage Meter	Digital Voltmeter

E		
E <sup>2</sup> MS	Electronic & Engineering Manufacturing Services	Elektronik Entwicklungs- und Fertigungs-Dienstleistung
EA	Each	Jeder
ECAD	Electronic Computer Aided Design	Rechnergestützte Elektronik-Konstruktion
EDA	Electronic Design Automation	Automatisierung der elektronischen Konstruktion
EDIF	Electronic Design Interchange Format	Herstellernerutrales, maschinenlesbares Format
EDX	Energy Dispersive X-ray spectroscopy	Energiedispersive Röntgenspektroskopie
EIA	Electronic Industries Association	Verband der Elektroindustrie der USA
EMC	Electromagnetic Compatibility	Elektromagnetische Verträglichkeit
EMI	Electromagnetic Interference	Elektromagnetische Interferenz
EMP	Electromagnetic Pulse	Elektromagnetischer Impuls
EMPB	First Article Report	Erstmusterprüfbericht
EMS	Electronic Manufacturing Services	Elektronik Fertigungs-Dienstleistung
ENEPIG	Electroless Nickel Electroless Palladium Immersion Gold	Chemisch Nickel-Palladium Gold
ENIG	Electroless Nickel Immersion Gold	Chemisch Nickel Gold
EOL	End-Of-Line	Linien-Ende(-Prüfung)
EOL	End-Of-Life	Ende des Lebenszyklus
EOS	Electrical Overstress	Elektrische Überbeanspruchung
EPA	ESD Protected Area	ESD-Schutzbereich
ERP	Enterprise Resource Planning	Unternehmens Ressourcen Planungstool
ESD	Electrostatic Discharge	Elektrostatische Entladung
ESDS	Electrostatic Discharge Sensitivity	Empfindlichkeit gegenüber elektrostatischer Entladung
ESR	Equivalent Series Resistance	Äquivalenter Reihenwiderstand
ESS	Environmental Stress Screening	Umweltstress-Screening
EVAL	Evaluation	Bewertung



F		
F	Fahrenheit	Fahrenheit
FA	Frist Article	Erstmuster
FAI	First Article Inspection	Erstmusterprüfung
FAR	First Article Report	Erstmusterprüfbericht
FAR	Failure Analysis Report	Fehleranalysebericht
FCT	Functional Circuit Test	Funktionstest auf Schaltungsebene
FEA	Finite-Element Analysis	Analyse der finiten Elemente
FED	Professional Design, PCB- and Electronic-Manufacturing Association	Fachverband für Design, Leiterplatten- und Elektronikfertigung
FEM	Finite-Element Modeling	Modelldarstellung mittels finiter Elemente
FET	Field Effect Transistor	Feldeffekt Transistor
FFT	Fast Fourier Transform	Schnelle Fourier Analyse
FMEA	Failure Mode And Effect Analysis	Fehlermöglichkeits- und -Einfluss Analyse
FOD	Foreign Object Debris	Beschädigung durch Fremdojekt
FOV	Field of View	Sichtfeld
FPGA	Field Programmable Gate Array	Im Feld programmierbare Gatter-Anordnung
FPT	Fine Pitch Technology	Feinstabstand Technologie
FPY	First Pass Yield	Erstausbeute
FR	Flame Retardant	Flammhemmend
Freq	Frequency	Frequenz
FT	Functional Test	Funktionstest
FTIR	Fourier Transform Infrared Spectroscopy	Spezielle Variante eines Spektrometers

G		
GaAs	Gallium Arsenide	Gallium-Arsenid
GND	Ground	Masse / Erdung

H		
H	Hydrogen	Wasserstoff
HAL	Hot Air Levelling	Heißluft-Verzinnen
HASL	Hot Air Solder Leveling	Heißluft-Verzinnen
HDI	High Density Interconnect	Hochdichte Verbindungstechnologie
HIC	Humidity Indicator Card	Feuchteindikatorenkarte
HPGL	Hewlett Packard Graphic Language	Hewlett Packard Graphic Language
Hz	Hertz (Frequency)	Hertz (Schwingungsfrequenz)

I		
I/O	Input / Output	Eingang / Ausgang
IC	Integrated Circuit	Integrierter Schaltkreis
IC	Ionic Chromatography	Ionen Chromatographie
IC	Ionic Contamination	Ionische Verunreinigung
ICT	In Circuit Test	Elektrischer Test der einzelnen Schaltkonten einer Baugruppe
IDC	International Electrotechnical Commission	Internationale Elektrotechnische Kommission
IL	Interlayer	Innenlage einer Leiterplatte
ILB	Inner-Lead Bond	Bondverbindung an Innenleiteranschluss
IMDS	International Material Data System	Internationale Material Datenbank
IMS	Insulated Metal Substrate	Metallkern-Leiterplatte
IPC	Institute for Printed Circuits / Institute for Interconnecting and Packaging Electronic Circuit	-
IR	Infrared	Infrarot
IR	Insulation Resistance	Isolationswiderstand
ISO	International Standards Organization	Internationale Normungsorganisation
IST	Individual Test Specimen	Einzel-Prüfling
ITP	Individual Test Pattern	Einzel-Prüfbild

J		
JEDEC	Joint Electron Device Engineering Council	-
JIS	Just in Sequence	Reihenfolge Synchronität
JIT	Just in Time	Zum richtigen Zeitpunkt
J-STD	Joint Standard	Gemeinsamer Standard
JTAG	Joint Test Action Group	-

K		
K	Kelvin	Kelvin
KGD	Known Good Die	nachweislich fehlerfreier Chip

L		
L	Inductor	Induktivität
LCC	Leadless Chip Carrier	Chip-Bauteil ohne Anschlussleiter
LCCC	Leadless Ceramic Chip Carrier	Keramik-Chip-Bauteil ohne Anschlussleiter
LCD	Liquid Crystal Display	Flüssigkristallanzeige
LDI	Laser Direct Imaging	Laserdirektbelichtung
LDS	Laser Direct Structuring	Laserdirektstrukturierung

LED	Light Emitting Diode	Leuchtdiode
LRC	Low Resin Content	Geringer Harzgehalt
LTB	Last-Time-Buy	Letzte Bestellmöglichkeit
LTCC	Low Temperature Co-Fired Ceramic	Niedertemperatur-Einbrand-Keramiken

M		
MAX	Maximum	Maximum
MBB	Moisture Barrier Bag	Feuchtigkeits-Schutzbeutel
MCAD	Mechanical Computer Aided Design	Rechnerunterstützte mechanische Konstruktion
MCAE	Mechanical Computer Aided Engineering	Rechnerunterstützte mechanische Technik
MCM	Multi Chip Module	Mehrfach Chip Modul
MCP	Multi Chip Package	Mehrfach Chip Gehäuse
MELF	Metal Electrode Face	Einzelbauelement mit stirnseitigen Metallelektrode ohne Anschlussleiter
MEMS	Micro Electro Mechanics System	Winzige Bauelemente, die Logikelemente und mikromechanische Strukturen in einem Chip vereinen
MES	Manufacturing Execution System	Prozessnahes mehrschichtiges Fertigungsmanagementsystem
MFG	Manufacturing	Herstellung
MID	Molded Interconnect Devices	Räumliche Elektronik
MIL-STD	US Military Standard	US-amerikanische Militärstandards
MIN	Minimum	Minimum
ML	Multilayer	Mehrlagen-Leiterplatte
MOI	Manual Optical Inspection	Manuelle Optische Inspektion
MOS	Metal Oxide Semiconductor	Halbleiter aus Metall Oxid Basis
MOSFET	Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor	Feldeffekt Transistor auf Metall Oxid Basis
MRB	Material Review Board	Material Abgleichfunktion (Bestand, Verbrauch, Bedarfe)
MRP	Material Requirement Planning	Materialbedarfsplanung
MRP	Manufacturing Resource Planning	Fertigungsbetriebsmittelplanung
MSD	Moisture Sensitive Device	Feuchteempfindliches Bauteil
MSDS	Material Safety Data Sheet	Sicherheitsdatenblatt
MSL	Moisture Sensitivity Level	Feuchtigkeitsempfindlichkeitsklasse
MTBF	Mean Time Between Failures	Mittlere Betriebszeit zwischen zwei ausfällen

N		
N	Nitrogen	Stickstoff
N	Newton	Newton
NA	Not Applicable	Nicht anwendbar
NADCAP	National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program	Globales kooperatives Akkreditierungsprogramm für Luft- und Raumfahrttechnik
NC	Numeric Control	Numerische Steuerung
NCNR	Not Cancelable, Not Returnable	Nicht Stornierbar, Nicht Retounierbar
NEG	Negative	Negativ
NF	No-Functional	Nicht funktional
Ni	Nickel	Nickel
NPI	New Product Introduction	Neuprodukteinführung
NPTH	Non Plated Thru Hole	Nicht durchmetallisiertes Loch
NRND	Not Recommended for New Designs	Nicht für Neuentwicklungen empfohlen
NSMD	Non-Solder mask Defined Pad	Lötstopplack bis vor die Anschlussfläche

O		
OBD++	CAD-to-CAM data exchange format between Development and Manufacturing of electronic products	Datenaustauschformat zwischen CAD, Entwicklung, CAM und Bestückung /Herstellung von elektronischen Geräten
OEM	Original Equipment Manufacturer	Erstausrüster
OL	Outer layer	Außenlage
ORT	Ongoing Reliability Test	Fortlaufende Zuverlässigkeitstest
OSP	Organic Solderability Preservative	Organischer Lötbarkeitsschutz
Oz	Ounce	Unze

P		
P&P	Pick and Place	Bestück Prozess (nehmen & setzen)
PB	Printed Board	Leiterplatte
Pb	Lead	Blei
PBGA	Plastic Ball Grid Array	Kunststoffgehäuse mit Rasteranordnung von Lotkugelanschlüssen
PCB	Printed Circuit Board	Gedruckte Schaltungsplatte (Analog Leiterplatte)
PCBA	Printed Circuit Board Assembly	Bestückte Leiterplatte
PCN	Product Change Notification	Produkt-Änderungs-Mitteilung
PCS	Pieces	Stück

PDM	Product Data Management	Produkt-Daten-Management
PDN	Product Discontinuance Notification	Produkt-Abkündigungs-Mitteilung
PGA	Pin Grid Array	Stiftmatrix Gehäuse
PICT	Process Ionic Contamination Testing	Prozessbegleitende Test auf Verunreinigung einer Schaltung durch Ionen
PiP	Pin in Paste Technology	Pin in Paste Technologie
PLC	Performance Level Categories	Messgröße für die Kriechstromfestigkeit (Leiterplatte)
PLCC	Plastic Leaded Chip Carrier	Kunststoff-Chip-Träger Gehäuse mit Anschlussleitern
PnP	Plug and Play	Anschließen und sofort benutzen
POP	Package on Package	Gehäuse auf Gehäuse Bestückung
POS	Positive	Positiv
POS	Position	Position
Post	After	Nach
PP	Prepreg	Zwischenfolie
PPM	Part Per Million	Teile pro eine Million
PPS	Production and Planning System	Produktionsplanungs- und Steuerungssystem
PQFP	Plastic Quad Flat Pack	Quadratisches Kunststoff-Flachgehäuse
Pre	Before	Vor
PSI	Pounds per Square Inch	Pfund pro Quadrat-Zoll
PSL	Product Sensitivity Level	Prozessempfindlichkeitslevel
PTH	Plated Thru Hole	Durchmetallisiertes Loch
PWB	Printed Wiring Board	Gedruckte Verdrahtungsplatte (analog Leiterplatte)

Q		
QA	Quality Assurance	Qualitätssicherung
QC	Quality Control	Qualitätssicherung
QFD	Quality Functional Deployment	Qualitätstechniker
QFJ	Quad Flatpack - J-Lead	Quadratisches Flachgehäuse mit J-Anschlüssen
QFN	Quad Flatpack - No Lead	Quadratisches Flachgehäuse ohne ausgeführte Anschlussleiter
QFP	Quad Flatpack	Quadratisches Flachgehäuse

R		
R	Resistor	Widerstand
REF	Reference	Referenz
REFDES	Reference Designator	Referenzbezeichner
REL	Release	Freigabe
RFQ	Request for Quotation	Angebotsanforderung

RH	Relative Humidity	Relative Feuchte
RoHS	Restriction of Hazardous Substances in electrical and electronic Equipment	Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräte

S		
S/N	Serial Number	Seriennummer
SAC	Sn-Ag-Cu Leadfree-Alloy	Zinn-Silber-Kupfer-Legierung (Bleifrei)
SAM	Scanning Acoustical Microscopy	Rasteraugenmikroskop
SEM	Scanning Electron Microscope	Rasterelektronenmikroskop
SFDC	Shop Floor Data Collection	Sammelsystem fertigungsbezogener Logdaten
SIG	Signal	Signal
SiP	System in Package	Gehäuse mit mehreren Chips als System
SIR	Surface Insolation Resistance	Oberflächenwiderstand
SM	Solder Mask	Lötstopmmaske
SMC	Surface Mount Component	Bauteil zur Oberflächenmontage
SMD	Solder Mask Defined pad	Lötstopplack bis auf die Anschlussfläche
SMD	Surface Mounted Device	Bauteil zur Oberflächenmontage
SMEMA	Surface Mount Equipment Manufacturers Association	Spezielle Kommunikationsschnittstelle
SMT	Surface Mount Technology	Oberflächenmontage-Technik
SMTA	Surface Mount Technology Association	-
Sn	Tin	Zinn
SnPb	Leaded solder	Bleihaltiges Lot
SOC	System on Chip	System in einem Chip
SOJ	Small Outline J-Lead	Rechteckiges Bauteilgehäuse mit J-Anschlüssen auf zwei gegenüberliegenden Seiten
SON	Small Outline No-Lead	Rechteckiges Bauteilgehäuse mit Anschlussflächen auf zwei gegenüberliegenden Seiten ohne Anschlussleiter
SOP	Small Outline Package	Rechteckiges Bauteilgehäuse mit S-Anschlüssen auf zwei gegenüberliegenden Seiten
SPC	Statistic Process Control	Statistische Prozesskontrolle
SPEC	Specification	Spezifikation
SPI	Solder Paste Inspection	Lotpasteninspektion
SPICE	Simulation Program Integrated Circuit Emphasis	Schaltungs-Simulations-Programm
SQ	Square	Quadrat
SS	Solder side	Lötseite

SSOP	Shrink SOP	Verkleinertes SOP
STD	Standard	Standard
STK	Stock	Lager
STK	Pieces	Stück
SYM	Symbol	Symbol

T		
T&C	Terms and Conditions	Geschäftsbedingungen
T260	Delamination Time @ 260 °C	Zeit bis Delamination bei 260 °C
T288	Delamination Time @ 288 °C	Zeit bis Delamination bei 288 °C
T300	Delamination Time @ 300 °C	Zeit bis Delamination bei 300 °C
TAP	Test-Access-Port	Test-Zugangs-Schnittstelle
TCE	Thermal Coefficient of Expansion	Wärmedehnungskoeffizient
TCR	Temperature Coefficient of Resistance	Temperaturkoeffizient des Widerstandes
Td	Decomposition Temperature	Zersetzungstemperatur
TEMP	Temperature	Temperatur
Tg	Glass Transition Temperature	Glasübergangstemperatur
THT	Thru Hole Technology	Durchstecktechnologie
Tj	Junction Temperature	Sperrschicht-Temperatur
TMA	Thermomechanical Analyze	Thermomechanische Analyse
TO	Transistor Outline	Transistorgehäuse
Tp	Peak Package Body Temperature	Maximale Gehäusekörpertemperatur
TP	Test point	Testpunkt
TQFP	Thin Quad Flat Pack	Dünnes quadratisches Flachgehäuse
TQM	Total Quality Management	Qualitätsmanagementsystem
TSOP	Thin SOP	Dünnes SOP
TTL	Transistor-Transistor-Logic	Transistor-Transistor-Logik
TYP	Type	Typ

U		
uC	Microcontroller	Ein-Chip-Computersystem
UL	Underwriters Laboratories	Unabhängige Organisation, die Produkte hinsichtlich ihrer Sicherheit untersucht und zertifiziert
UOS	Unless Otherwise Specified	Wenn nicht anders Spezifiziert
UUT	Unit Under Test	Einheit im Test

V		
VDA	-	Verband der Automobilindustrie
VDE	-	Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik

VHDL	Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language	Hardwarebeschreibungssprache
VIPPO	Via-In-Pad Plated Over	Geschlossenes Durchkontaktierung in einer Anschlussfläche
VP	Vapor Phase	Dampfphase

<b>W</b>		
WBP	Wire Bond Pad	Drahtbond-Anschlussfläche
WEEE	Waste of Electrical and Electronic Equipment	Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall
WIP	Work in Process	Umlaufbestand
WLP	Wafer Level Package	Nacktchip-Verkapselung

<b>Z</b>		
ZIF	Zero Insertion Force	Null Einsteckkraft
Zn	Zinc	Zink
ZVEI	-	Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie



# Fazit

Wir hoffen, dieses eBook ist Dir in deinem täglichen Tun eine Hilfe. Es kann nicht alle Akronyme und Abkürzungen vollständig abhandeln. Wir waren jedoch sehr bemüht, aus der Sichtung von über 100 Dokumenten, Büchern, Publikationen und Datenblättern die gebräuchlichsten 333 Akronyme und Abkürzungen herauszufiltern und zu beschreiben.

Solltest Du jedoch das eine oder andere wichtige Akronym oder Abkürzung vermissen, so lass es uns wissen und wir werden es prüfen und mit aufnehmen.

[kontakt@electronic-academy.com](mailto:kontakt@electronic-academy.com)

Als ideale Ergänzung können wir Dir unser eBook: „Begriffe und



Definitionen der Elektronikproduktion“ empfehlen. Dort findest Du zu den jeweiligen Fachbegriffen eine ausführliche Definition und Beschreibung mit den dazu passenden Schaubildern.

Sichere Dir dieses ergänzende eBook jetzt mit

**33% RABATT**

auf den regulären Verkaufspreis mit dem Gutscheincode:

**333Akronyme**

Gehe jetzt auf:

[www.electronic-academy.com/definitionsbuch](http://www.electronic-academy.com/definitionsbuch)

und sichere dir noch heute Dein Exemplar.

# Über Andreas Walter

Andreas Walter ist seit mehr als 25 Jahren in der Elektronikproduktion tätig. In seinen Stationen vom Prüftechniker im Schichtbetrieb, in der Arbeitsvorbereitung, als Kalkulator, Programm Manager, Abteilungsleiter, Produktionsleiter bis hin zum Geschäftsführer eines EMS Unternehmens konnte er sich ein sehr breites, aber auch sehr tiefes Fachwissen aneignen.



Er ist international geschätzt für sein fundiertes Fachwissen und für seine Fähigkeit, komplexer Prozesse und Zusammenhänge schnell zu verstehen. Dabei agiert er stets lösungs- und kundenorientiert. Seine offene und kompetente Arbeitsweise ist bei Kunden, Lieferanten und Partnern sehr geschätzt.

Mit der Electronic Academy hilft er Unternehmen weltweit, ihre Elektronik-Entwicklung das Elektronicsourcing und die jeweiligen Produktionsstandorte mit dem richtigen Know-How auszustatten. Von der Planung über die Konzeption bis hin zur zielführenden Implementierung.

Zusammen mit Andreas Walter und der Electronic Academy nachhaltig zu schneller Produktumsetzung, und fachlich gut gebildeten sowie engagierten Mitarbeitern.

Der Mehrwert für Ihr Unternehmen: bessere Produkte, motivierte Mitarbeiter und dadurch eine Steigerung der Kundenzufriedenheit.

# Hinweise

Dieses eBook ist ein urheberrechtlich geschütztes Eigentum.

Die unerlaubte Verbreitung, auch auszugsweise, wird überwacht und bei Zuwiderhandlung straf- und zivilrechtlich verfolgt.

Autor dieses eBooks: Andreas Walter

Trotz sorgfältiger Prüfung kann keine Haftung über die in diesem eBook vermittelten Informationen übernommen werden. Die Überprüfung und Anwendung der einzelnen Informationen obliegen jedem einzelnen Leser.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und wertvolle Impulse mit dem eBook.

## Impressum:

Angaben gemäß § 5 TMG:

Electronic Academy

Andreas Walter

Im Hohen Bühl 13

91174 Spalt

## Kontakt:

Telefon: +49 (0)9873 784 99 99

E-Mail: [kontakt@electronic-academy.com](mailto:kontakt@electronic-academy.com)